

# 深南电路股份有限公司

## 2024 年度财务预算报告

### 一、行业格局及发展趋势

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项业务。公司已成为中国电子电路行业的领先企业，中国封装基板领域的先行者，电子装联特色企业，系国家火炬计划重点高新技术企业、电子电路行业首家国家技术创新示范企业和国家企业技术中心、中国电子电路行业协会（CPCA）理事长单位及标准委员会会长单位。

目前，公司已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、内资最大的封装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商、电子装联制造的特色企业。根据2023年第四季度Prismark行业报告显示，2023年公司在全球印制电路板厂商中位列第八。

#### 1、印制电路板（含封装基板）行业发展情况

根据Prismark2023年第四季度报告统计，2023年以美元计价的全球PCB产业产值同比下降15.0%。

从中长期看，产业将保持稳定增长。2023-2028年全球PCB产值的预计年复合增长率达5.4%。从区域看，全球各区域PCB产业均呈现持续增长态势。其中，中国大陆地区复合增长率达4.1%。从产品结构看，封装基板、18层及以上的高多层板、HDI板将保持相对较高的增速，未来五年复合增速分别为8.8%、7.8%、6.2%。

2023-2028 年 PCB 产业发展情况预测（按地区）

单位：百万美元

类型/年份	2022	2023E		2028E	2023-2028E
	产值	同比	产值	产值	复合增长率
美洲	3,369	-4.8%	3,206	3,855	3.8%
欧洲	1,885	-8.3%	1,728	2,002	3.0%
日本	7,280	-16.5%	6,078	7,904	5.4%
中国大陆	43,553	-13.2%	37,794	46,180	4.1%
亚洲（日本、中国大陆除外）	25,654	-19.3%	20,710	30,472	8.0%
合计	81,740	-15.0%	69,517	90,413	5.4%

数据来源：Prismark 2023 Q4 报告

对于封装基板产品，一方面人工智能、云计算、智能驾驶、万物互联等产品技术升级与应用场景拓展，驱动电子产业对高端芯片和先进封装需求的大幅增长，从而带动了全球封装基板产业在长期保持增长，尤其是推动了应用于高算力、集成化等场景的高阶封装基板产品呈较高增速的态势。另一方面，国内加大对半导体产业发展的支持力度，相关投资增加将进一步加速国内封装基板产业发展。从短期看，随着终端厂商半导体库存逐步回归正常水平，世界半导体贸易统计组织预计2024年全球半导体市场将同比增长13.1%。

对于PCB产品，服务器和数据存储、通信、新能源和智能驾驶以及消费电子等市场仍将是行业长期的重要增长驱动力。从云端看，随着人工智能的加速演进，ICT产业对于高算力和高速网络的需求日益紧迫，驱动了对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶HDI、高散热PCB产品需求的快速增长。从终端看，随着AI在手机、PC、智能穿戴、IOT等产品的应用的不断深化，各类终端应用对边缘计算能力和数据高速交换与传输的需求迎来爆发式增长。在上述趋势驱动下，终端电子设备对高频高速、集成化、小型化、轻薄化、高散热等相关PCB产品需求的持续增长。

## 2、电子装联行业发展状况

电子装联在行业上属于EMS行业，行业狭义上指为各类电子产品提供制造服务的产业，代表制造环节的外包。目前全球EMS行业的市场集中度相对较高，国际上领先的EMS厂商均具备为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌、销售以外服务的能力。电子装联行业供应链较为复杂，涉及包括PCB、芯片、主被动元件等在内的各种电子元器件，故供应链更容易受到上游零件短缺的冲击，因此供应链能力也逐渐成为电子装联行业的核心竞争力之一。

2023年以来，全球多个国家、地区生产物流有所恢复，叠加下游终端客户持续去库存，电子产业的芯片与其他电子元器件供应环境改善明显。

## 二、公司发展战略

公司将持续专注于电子互联领域，围绕“3-In-One”战略，发挥业务协同优势将核心业务做强做优做大，全面提升各业务技术、质量及运营能力，加速业务融合发展，发挥公司电子互联产品技术平台优势，推进转型升级，打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商，成为受全球领先客户认可的电子互联技术领导者。

### 三、2024 年经营计划

从宏观层面看，根据世界银行最新发布的 2024 年全球经济展望，预计 2024 年全球经济增速为 2.4%，同比下滑约 0.2pct。而电子产业与宏观经济高度相关，因此 2024 年公司面临的整体需求环境仍不乐观。

公司 2024 年将继续坚持“3-In-One”战略，积极应对宏观经济的不利因素，紧抓市场机会，同时持续加强运营管理工作，确保实现稳健增长。一方面重点加快 FCBGA 产品线能力建设，推进广州项目爬坡；另一方面通过提升产品线竞争力、提升运营效率、降低成本费用等举措支撑各项业务实现预期目标。

PCB 业务 2024 年将继续优化下游市场产品结构，聚焦战略目标客户的开发突破，增强国际化的市场拓展能力；进一步提升工艺技术能力和研发水平，满足客户对新产品开发的需求；继续推进系统级降本工作，夯实运营能力，优化质量管理水平，强化成本竞争力。

封装基板业务 2024 年将抓住半导体市场需求机会，重点推进战略目标客户开发与关键项目落地；推动无锡封装基板二期实现盈利、加快 FCBGA 产品线竞争力建设，支撑广州项目顺利爬坡。

电子装联业务 2024 年将继续以数据中心、汽车等市场领域为重点，并持续深耕通信、工控、医疗等领域。内部将继续以运营、技术、供应链等为抓手，通过强化辅助设计与增值服务能力，更好地服务客户需求，持续加强电子装联业务的综合竞争力。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十四日